

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司

关于与电子科技大学、石家庄市鹿泉区人民政府签订共建联合实验室协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、协议签署情况

为提升石家庄银河微波技术股份有限公司（以下简称“公司”）新产品研发能力，促进高校科技成果产业化，促进石家庄市新一代电子信息产业发展，经三方友好协商，公司拟与电子科技大学、石家庄市鹿泉区人民政府共建“电子科技大学-银河微波河北芯片与微系统集成技术创新联合实验室”（以下简称“联合实验室”），并签署相关合作协议。

公司及控股股东、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员均与电子科技大学、石家庄市鹿泉区人民政府不存在关联关系，本次公司与电子科技大学、石家庄市鹿泉区人民政府签署合作协议事项不构成关联交易。

2024年1月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟与电子科技大学、石家庄市鹿泉区人民政府共建联合实验室的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、合作内容

1、联合实验室名称：电子科技大学-银河微波河北芯片与微系统集成技术创新联合实验室。

2、实验室定位：联合实验室定位在高端研发创新平台，围绕服务空天信息产业，开展前沿技术的研究,服务石家庄市电子信息产业发展。

3、合作模式：联合实验室依托电子科技大学集成电路科学与工程学院科研平台、“电子薄膜与集成器件全国重点实验室”和公司“河北省微波毫米波电路与系统技术创新中心”平台建设，在石家庄市鹿泉区人民政府的政策扶持下，开展联合实验室设定课题的研究工作。

4、合作期限：联合实验室合作期为3+2年，首期合作期限为三年，期满后自动续约两年。

5、研发课题方向：

(1) 微系统集成技术与工艺研究，基于SIP微系统集成技术的下一代军用及航空航天用微小型数据链产品和TR组件的开发；

(2) 专用射频集成电路研究；

(3) 下一代半导体陶瓷封装材料的研究；

(4) 第三代功率半导体相关技术研究。

三、协议履行对公司的影响

本次合作共建联合实验室，以产学研相结合的方式进行科学研究、技术开发和人才交流，符合公司发展规划，公司将借助电子科技大学雄厚的科研实力和平台优势，进一步储备更多产品和技术，提升公司核心竞争力；同时，通过与电子科技大学开展学术及技术等方面的交流，将促进公司在技术研发、人才培养等方面进一步提高，对公司未来业务发展、技术水平提升具有积极促进作用。

本协议签订对公司业务的独立性无重大影响，对当期业绩和财务状况不构成重大影响，不存在损害股东利益的情形。

四、风险提示

本协议执行过程中，联合实验室能否良好运营和取得预期效果受行业政策、管理水平和科技水平等多种因素的影响，具体研发项目能否取得显著的研究成果存在一定的不确定性，可能存在研发不达预期、研发终止等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一) 《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《联合实验室合作协议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会

2024年1月23日